



POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Digi International Va Présenter les Dernières Avancées des Technologies IdO à Embedded World 2017

Digi Célèbre le 15^{ème} Anniversaire d'Embedded World en Montrant un Leadership d'Entreprise et en Présentant des Solutions Critiques à la Communauté Internationale

PARIS, 7 mars 2017 – Digi International®, (NASDAQ : DGII, www.digi.com), fournisseur leader mondial de produits et de services essentiels de connectivité IdO et *machine-to-machine* (M2M), a aujourd'hui annoncé les activités et événements principaux qui auront lieu lors d'[Embedded World](#). L'évènement aura lieu au Parc des Expositions de Nuremberg du 14 au 16 mars 2017. Digi exposera conjointement ses solutions dans le Hall 3, sur les stands 3-141 et 3-310.

Au cours de cet événement de trois jours, les représentants de Digi feront une série de présentations et de démonstrations continues mettant en scène un certain nombre de produits IdO et M2M de Digi. L'entreprise discutera de ses innovations de produits et des détails concernant ses futurs Ordinateurs à Carte Unique ConnectCore® pour i.MX6UL, le Modem Cellulaire NB-IoT Digi XBee® et les plans de produits pour la spécification LoRa. Digi offrira également aux visiteurs la possibilité de commander les Kits de Démarrage et de Développement ConnectCore pour i.MX6UL.

« Digi International et Embedded World ont depuis longtemps l'habitude de présenter des solutions axées sur le marché permettant la réalisation d'avancées, » a déclaré Kevin C. Riley, directeur de l'exploitation de Digi International. « En tant qu'évènement mondial de premier plan, Embedded World est le lieu parfait pour présenter de nouveaux produits faisant avancer l'industrie de l'IdO. »

Démonstrations et Présentations de Produits

Les représentants de Digi présenteront des solutions actuelles, offriront un aperçu des produits à venir et organiseront des séances de formation, dont ce qui suit :

- **Système sur Module (SOM) ConnectCore 6UL**– Le SOM ConnectCore pour i.MX6UL est conçu comme une plateforme intégrée intelligente et sécurisée destinée aux fabricants de dispositifs créant des appareils connectés très économiques et fiables, sans le risque de conception logicielle ou matérielle habituel. Basé sur le processeur d'applications

i.MX 6UltraLite de NXP, le module propose le facteur de forme monté à plat unique Digi SMTplus™ (brevet déposé) qui est à peine plus grand qu'un timbre-poste. Il inclut également en option une connectivité sans fil Bluetooth 4.2 et 802.11ac, une température de fonctionnement industrielle, deux options d'intégration à moindre coût (LGA et vias crénelés sur bord) et un fonctionnement à très basse consommation (jusqu'à 35 µA) de pointe utilisant des capacités Microcontroller Assist™ (MCA) totalement intégrées.

- **Ordinateurs à Carte Unique (SBC) ConnectCore 6UL** – Digi présentera les capacités des futurs Ordinateurs à Carte Unique (SBC) ConnectCore pour i.MX6UL. Les SBC ConnectCore 6 pour i.MX6UL offrent des ordinateurs à carte unique standards, pré-certifiés possédant une connectivité filaire et sans-fil, des options de connectivité cellulaire, un support Linux complet Yocto Project et une intégration complète de la sécurité des appareils Digi TrustFence™. Les facteurs de forme du ConnectCore 6 pour i.MX6UL SBC Pro (100 x 72 mm, Pico-ITX) et du ConnectCore pour i.MX6UL SBC Express (87 x 63 mm) sont des plateformes optimisées pour un large éventail d'applications de qualité industrielle, et ils permettent un délai de commercialisation drastiquement réduit en éliminant la nécessité d'un design de matériel sur-mesure.
- **Modem Cellulaire NB-IoT Digi XBee®** – Digi présentera la version européenne du Modem Cellulaire Digi XBee conçu pour Cat NB-IoT. Optimisé pour les réseaux Vodafone en Europe, cette version du Modem Cellulaire permettra à tous les Fabricants de Matériel d'Origine (OEM) d'intégrer facilement et rapidement le cellulaire NB-IoT dans leurs designs avec une consommation d'énergie faible, stable et peu coûteuse qui comprend une sécurité intégrée supplémentaire.
- **Digi XBee® LoRa et Digi XBee® LoRaWAN™** - Attendu en 2017 pour les marchés européens et nord-américains, Digi a commencé le développement du Digi XBee pour les plateformes sans-fil LoRa et LoRaWAN, notamment des passerelles et des modules intégrés. Les participants d'Embedded World sont invités à rendre visite aux représentants de Digi pour en savoir plus à propos de la feuille de route et des offres du Digi XBee LoRa.
- **Séances de formation** – Le jeudi 16 mars de 11h30 à midi, Mike Rohmoser, directeur de la gestion des produits, systèmes intégrés, chez Digi International, interviendra au cours de la séance numéro 33 intitulée « Choisir le Bon SOC/SOM pour la Connectivité M2M Sans-Fil. » Cette séance étudiera le système-sur-puce (SOC) et le système-sur-module (SOM) en tant que plateforme idéale pour un design de produits ciblé et rapide.
- **Co-exposants et participation de partenaires** - Digi exposera des solutions avec ses partenaires dans l'ensemble du site, notamment Arrow Electronics (Hall 4A, stand 4A-340), Atlantik Elektronik (Hall 3, stand 3-141), CODICO (Hall 3, stand 3-310), Digi-Key Electronics (Hall 4A, stand 4A-631) et NXP Semiconductors (Hall 4A, stand 4A-220).
 - **Démonstrations sur stand** (stands Atlantik et CODICO)
 - ConnectCore pour i.MX6UL – La démonstration interactive présentera les principales caractéristiques du solide SOM ConnectCore pour i.MX6UL

SOM, notamment la sécurité Digi TrustFence, le fonctionnement à très faible consommation d'énergie, l'intégration de capteurs, la connectivité au cloud, l'intégration de l'affichage et les capacités d'interface utilisateur.

- Digi XBee ZigBee – Cette démonstration met en avant une application d'éclairage industriel connectée au cloud comprenant le module Digi XBee ZigBee et une passerelle Digi XBee ZigBee afin de créer une solution d'éclairage maillé pouvant être contrôlée et contrôlée à distance.

Une faible quantité de modules et de Kits de Démarrage et de Développement ConnectCore pour i.MX6UL sont actuellement disponibles. La disponibilité générale pour les commandes de production de modules sera le 30 mars 2017. Les personnes présentes à Embedded World pourront commander le Kit de Développement ConnectCore pour i.MX6UL auprès de partenaires au prix réduit pour le salon Embedded World de 99 USD (Prix public conseillé : 249 USD).

A propos de Digi International

Digi International®, (NASDAQ : DGII) est un fournisseur leader mondial de produits et de services essentiels de connectivité IdO et *machine-to-machine* (M2M). Nous aidons nos clients à créer la prochaine génération de produits connectés. Nous déployons et gérons des infrastructures de communications essentielles dans des environnements exigeants avec des niveaux élevés de sécurité, une fiabilité continue et des performances à toute épreuve. Fondés en 1985, nous avons aidé nos clients à connecter plus de 100 millions d'objets et ce chiffre continue d'augmenter. Pour de plus amples informations, visitez le site internet de Digi, www.digi.com, ou appelez le 877-912-3444 (depuis les Etats-Unis) ou le 952-912-3444 (à l'international).

Correspondants Médias :

Europe

Vibeke Ulmann

Catalyst Communications

Bureau : +44 (0)1323 760 335

vibeke.ulmann@catalystpr.com

Amérique du Nord

Rick McLaughlin

LEWIS

Bureau : +1 781-418-2402

rick.mclaughlin@teamlewis.com